

DWG. NO. SD-53309-***27

E

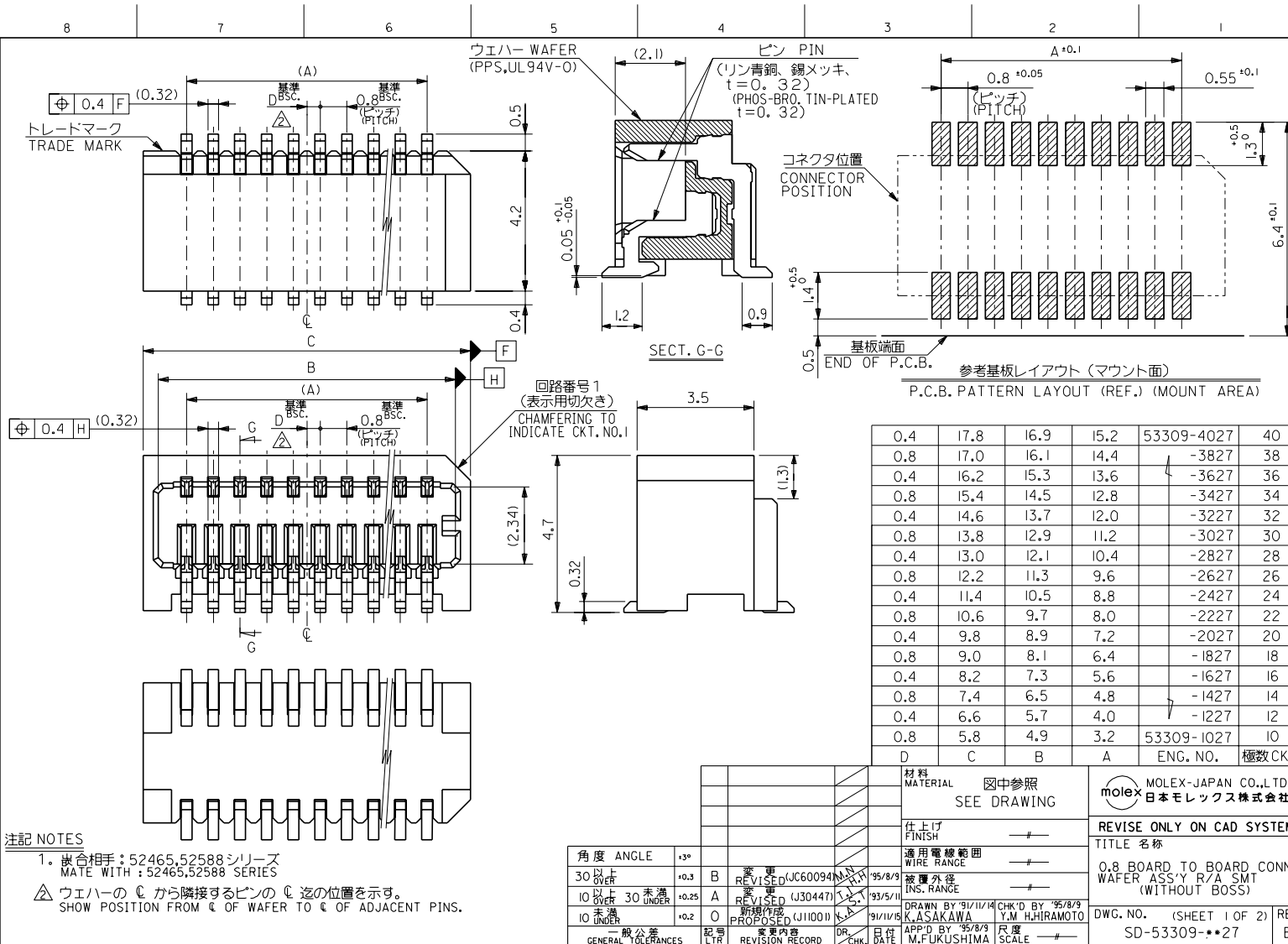
D

C

B

A

1MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



0.4	17.8	16.9	15.2	53309-4027	40
0.8	17.0	16.1	14.4	-3827	38
0.4	16.2	15.3	13.6	-3627	36
0.8	15.4	14.5	12.8	-3427	34
0.4	14.6	13.7	12.0	-3227	32
0.8	13.8	12.9	11.2	-3027	30
0.4	13.0	12.1	10.4	-2827	28
0.8	12.2	11.3	9.6	-2627	26
0.4	11.4	10.5	8.8	-2427	24
0.8	10.6	9.7	8.0	-2227	22
0.4	9.8	8.9	7.2	-2027	20
0.8	9.0	8.1	6.4	-1827	18
0.4	8.2	7.3	5.6	-1627	16
0.8	7.4	6.5	4.8	-1427	14
0.4	6.6	5.7	4.0	-1227	12
0.8	5.8	4.9	3.2	53309-1027	10
D	C	B	A	ENG. NO.	極数 CKT.

注記 NOTES
 1. 嵌合相手: 52465,52588 シリーズ
 MATE WITH: 52465,52588 SERIES
 △ ウェハーの ϕ から隣接するピンの ϕ 迄の位置を示す。
 SHOW POSITION FROM ϕ OF WAFER TO ϕ OF ADJACENT PINS.

角度 ANGLE	$\pm 3^\circ$
30 以上 OVER	± 0.3 B 変更 REVISD (JC60094) 95/8/9
10 以上 未過	± 0.25 A REVISD (J30447) 93/5/11
10 以下 未過	± 0.2 O 新規作成 PROPOSED (J11001) 91/11/5
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR 変更内容 DR. CHK. 日付 DATE

材料 MATERIAL	図中参照 SEE DRAWING
仕上げ FINISH	---
適用電線範囲 WIRE RANGE	---
被覆外径 INS. RANGE	---
DRAWN BY	91/11/14 K. SAKAWA
CHK'D BY	95/8/9 Y.M. HIRAMOTO
APPR'D BY	95/8/9 M. FUKUSHIMA
尺度 SCALE	---

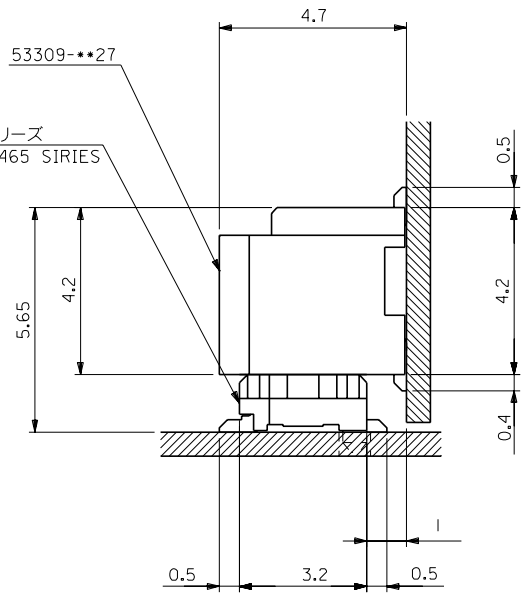
MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	
0.8 BOARD TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y R/A SMT (WITHOUT BOSS)	
DWG. NO.	(SHEET 1 OF 2) REV B
SD-53309-***27	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-53309-**27

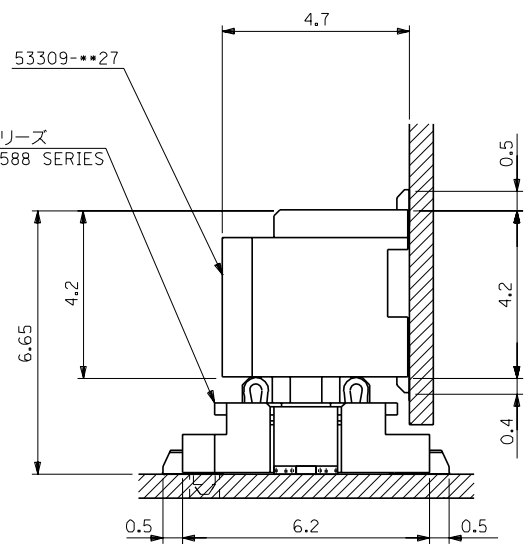
ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

嵌合相手 52465 シリーズ
MATES WITH 52465 SERIES



嵌合状態図 (参考)
MATED DRAWING(REF.)

嵌合相手 52588 シリーズ
MATES WITH 52588 SERIES



嵌合状態図 (参考)
MATED DRAWING(REF.)

角度 ANGLE	公差 TOL.	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. / CHK.	日付 DATE	材料 MATERIAL	仕上り FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	尺度 SCALE
30以上 OVER	+0.3	B	変更 REVISD(JC60094)	MAN	95/8/9	SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2	—	—	—	—
10以上 未満 OVER 30 UNDER	+0.25	A	変更 REVISD(J30447)	Y.S.	93/5/11		—	—	—	—
10未満 UNDER	+0.2	O	新規作成 PROPOSED(J11001)	K.A.	91/11/6		—	—	—	—
一般公差 GENERAL TOLERANCES										

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
0.8 BOARD TO BOARD CONN.
WAFER ASSY R/A SMT
(WITHOUT BOSS)

DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV
SD-53309-**27 B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32